


Especificações detalhadas do Dell™ Studio XPS™ 8000

Este documento fornece informações de que poderá precisar para a configuração, actualização de controladores e actualização do computador.

NOTA: As ofertas podem variar consoante a região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar**  **Ajuda e suporte** e seleccione a opção para visualizar informações sobre o computador.

Processador	Conectores da placa de sistema
Unidades e dispositivos	Conectores externos
Memória	Ranhuras de expansão
Informações do computador	Alimentação
Bus de expansão	Bateria
Vídeo	Características físicas
Áudio	Ambiente do computador
Leitor de cartões de memória	

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida a reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais mencionadas neste texto: *Dell*, o logótipo *DELL* e *Studio XPS* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* é uma marca registada e *Core* é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e noutros países; *Blu-ray Disc* é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* é uma marca registada propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é utilizada pela Dell sob licença.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser mencionados neste documento como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes de terceiros.

Modelo: Série D03M

Tipo: D03M001

Agosto de 2009

Rev. A00

Processador

Tipo	Intel® Core™ i7-870 Intel Core i7-860 Intel Core i5-750
Cache L1	32 KB
Cache L2	256 KB
Cache L3	8 MB

[Voltar ao início](#)

Unidades e dispositivos

Acessíveis externamente	<ul style="list-style-type: none"> dois compartimentos de 5,25 polegadas para SATA DVD+/-RW Super Multi Drive ou combo Blu-ray Disc™ ou unidade RW de Blu-ray Disc um compartimento de 3,5 polegadas para Flexdock ou
-------------------------	---

	um módulo Bluetooth®
Sem fios (opcional)	Tecnologia sem fios Bluetooth®
Acessíveis internamente	dois compartimentos de 3,5 polegadas para unidades de disco rígido SATA

[Voltar ao início](#)

Memória

Conectores	quatro sockets DDR3 DIMM acessíveis internamente
Capacidades	1 GB, 2 GB e 4 GB
Tipo de memória	DDR3 DIMM de 1066-MHz ou 1333 MHz; apenas memória não ECC
Configurações de memória possíveis	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB (sistema operativo de 64 bits)

[Voltar ao início](#)

Informações do computador

Chipset do sistema	Intel P55
Largura do barramento de dados	2,5 GT/s
Largura de barramento DRAM	64 bits
Largura de barramento do endereço do processador	64 bits
Suporte para RAID (apenas para unidades SATA internas)	RAID 0 (striping) RAID 1 (mirroring)
Chip BIOS (NVRAM)	8 MB
Velocidade da memória	1333 Mhz

[Voltar ao início](#)

Bus de expansão

PCI Express	<ul style="list-style-type: none"> • velocidade bidireccional de ranhuras Gen2 x1 — 500 MB/s • velocidade bidireccional de ranhuras Gen2 x16 — 16 GB/s
-------------	--

PCI	velocidade de 32 bits — 33 MHz
SATA 2.0	1,5 Gbps e 3,0 Gbps
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • alta velocidade — 480 Mbps • velocidade completa — 12 Mbps • baixa velocidade — 1,2 Mbps

[Voltar ao início](#)

Vídeo

Separado	Placa PCI Express x16
----------	-----------------------

[Voltar ao início](#)

Áudio

Tipo	Canal integrado 7.1, áudio de alta definição com suporte para S/PDIF
------	--

[Voltar ao início](#)

Leitor de cartões de memória

Cartões suportados	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão CompactFlash (CF) • Cartão Smart Media (SM) • Cartão xD-Picture (xD) • Cartão Memory Stick (MS) • Cartão Memory Stick PRO (MSPRO) • Cartão Memory Stick PRO HG (MSPRO HG) • Cartão SecureDigital (SD) • Cartão SecureDigital (SDHC) 2.0 • Cartão MultiMedia Card (MMC) • MicroDrive (MD)
--------------------	--

[Voltar ao início](#)

Conectores da placa de sistema

Memória	quatro conectores de 240 pinos
PCI	um conector de 124 pinos
PCI Express x1	dois conectores de 36 pinos
PCI Express x16	um conector de 164 pinos
Alimentação (placa de sistema)	um conector de 12V EPS de 24 pinos

	(compatível com ATX)
Ventoinha do processador	um conector de 4 pinos
Ventoinha do chassis	um conector de 3 pinos
Conector USB na parte da frente	cinco conectores de 9 pinos
Conector de áudio na parte da frente	um conector de 9 pinos para som estéreo de 2 canais e microfone
SATA	quatro conectores de 7 pinos
Saída S/PDIF	conector de 5 pinos

[Voltar ao início](#)

Conectores externos

Adaptador de rede	conector RJ45
USB	dois no painel superior, dois no painel frontal e quatro conectores compatíveis com USB no painel posterior
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> • painel superior - conectores para auscultadores e microfone • painel posterior - seis conectores para suporte 7.1
S/PDIF	um conector S/PDIF (óptico)
eSATA	um conector no painel posterior
IEEE 1394a	um conector de série de 6 pinos no painel posterior

[Voltar ao início](#)

Ranuras de expansão

PCI	
Conectores	um
Tamanho do conector	conector de 124 pinos
Largura de dados do conector (máxima)	32 bits
PCI Express x1	
Conectores	dois
Tamanho do conector	conector de 36 pinos
Largura de dados do conector (máxima)	1 via PCI Express
PCI Express x16	
Conectores	um

Tamanho do conector	conector de 164 pinos
Largura de dados do conector (máxima)	16 via PCI Express

[Voltar ao início](#)

Alimentação

Fonte de alimentação DC	
Potência	350 W
Dissipação de calor máxima	1836 BTU/h
NOTA: A dissipação de calor é calculada utilizando a classificação de potência da fonte de alimentação.	
Tensão de entrada	115/230 VAC
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente de saída nominal	8 A/4 A
Bateria de célula tipo moeda	célula tipo moeda CR2032 de 3 V

[Voltar ao início](#)

Bateria

Bateria de célula tipo moeda	célula tipo moeda CR2032 de 3 V
------------------------------	---------------------------------

[Voltar ao início](#)

Características físicas

Altura	407,75 mm
Largura	185,81 mm
Profundidade	454,67 mm
Peso	10,18 kg

[Voltar ao início](#)

Ambiente do computador

Variação da temperatura:	
Funcionamento	10 °C a 35 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C
Humidade relativa	20% a 80%

	(sem condensação)
Vibração máxima (utilizando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do utilizador):	
Funcionamento	0,25 G RMS
Armazenamento	2,2 G RMS
O choque máximo (medido com o disco rígido na posição de repouso e um impulso semi-senoidal de 2 ms):	
Funcionamento	Impulso semi-senoidal: 40 G para 2 ms com uma alteração de velocidade de 51 cm/s
Armazenamento	Impulso semi-senoidal: 50 G para 26 ms com uma alteração de velocidade de 813 cm/s
Altitude (máxima):	
Funcionamento	-15,2 a 3048 m (-50 a 10.000 pés)
Armazenamento	-15,2 a 10.668 m (-50 a 35.000 pés)
Nível de contaminação pelo ar	G2 ou inferior, como definido pela ISA-S71.04-1985

[Voltar ao início](#)